

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯國際截至二零一三年九月三十日止三個月未經審核業績公佈

- 包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，二零一三年第三季銷售額為伍億參仟肆佰參拾萬元，與二零一二年第三季相比增加 15.8%，與二零一三年第二季相比下降 1.3%。
- 不包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，二零一三年第三季非公認準則的銷售額為伍億零參佰柒拾萬元，與二零一二年第三季相比增加 21.7%，與二零一三年第二季相比上升 0.4%。
- 二零一三年第三季中國區銷售額佔總銷售額的比率是創新高的 42.1%，相比二零一二年第三季為 35.3%，二零一三年第二季為 40.9%。
- 包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，二零一三年第三季毛利率為 21.0%，相比二零一二年第三季為 27.5%，二零一三年第二季為 25.0%。
- 不包括來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，二零一三年第三季非公認準則的毛利率為 22.1%，相比二零一二年第三季為 30.4%，二零一三年第二季為 26.7%。
- 二零一三年第三季的中芯國際應佔盈利為肆仟貳佰伍拾萬元，相比二零一二年第三季為壹仟貳佰萬元，二零一三年第二季為柒仟伍佰肆拾萬元。

以下為本公司於二零一三年十月二十二日就截至二零一三年九月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

本公司自二零一二年起依國際財務報告準則編製年度合併財務報告，所有前期可比較財務資訊已按照國際財務報告準則之規定予以重分類。

中國上海 — 2013 年 10 月 22 日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一三年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一三年第四季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 不包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，季度非公認準則的收入預期持平至下降 4.5%，來自武漢新芯的銷售額正於二零一三年第三季起逐步結束。
- 包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，季度收入預期下降 4.5%至下降 9.0%。
- 不包含來自武漢新芯的晶圓轉單，非公認準則的毛利率預期在 19.0%至 22.0%範圍內。
- 包含來自武漢新芯的晶圓轉單，毛利率預期在 18.5%至 21.5%範圍內。
- 非公認準則的經營開支為扣除匯兌損益、雇員花紅計提數、在研究發展的合約上獲得政府支持的資金以及出售生活園區資產收益影響後，預期將介於 80 百萬元至 84 百萬元之間。

首席執行官兼執行董事邱慈雲博士評論說：“中芯國際在二零一三年第三季度，再次取得了不錯的業績。不包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額達到 5 億零 3 百 70 萬元，比二零一二年第三季度強勁增長 21.7%，比二零一三年第二季度增長 0.4%。由於我們已經退出了和武漢新芯的合作關係，包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，二零一三年第三季銷售額比二零一三年第二季度下降 1.3%。我也很高興向各位報告，二零一三年第三季中芯國際應佔盈利為 4 仟 2 百 50 萬元，連續第六季錄得淨盈利。”

我很高興向各位宣佈，在二零一三年第三季度，我們 40 納米製程貢獻的銷售額比上一季增長 50.3%，對晶圓銷售額的貢獻上升至 15.7%。這個增長主要是由智慧型手機相關產品帶動的。同時，我們 40 納米製程產品流片啟動在今年下半年增長顯著，主要是由消費類產品和通訊類產品帶動的，如智慧型手機，機頂盒，互動式網路電視，及平板電腦。由此，我們的目標是明年 40 納米製程業務繼續強勢增長。

在二零一三年第三季，市場對我們差異化產品的需求持續走強，特別是電源管理、攝像頭芯片及 EEPROM 這一塊。差異化產品的銷售額，如電源管理、攝像頭芯片及 EEPROM，二零一三年第三季度比二零一二年第三季度增長超過 50%。

我們的目標是在二零一三年再創年度銷售額新高，可持續盈利和增長是我們的首要目標。展望二零一四年，我們的目標是銷售額成長再次超過行業的平均水準。在我們面前有許多令人激動的機遇。1) 我們的 40 納米產能將持續上量。2) 我們 28 納米技術即將上線。3) 非揮發性嵌入式記憶體工藝得到了客戶廣泛的認可。4) 許多其他的差異化技術將在二零一四年上量生產。最後，我們先進製程和成熟製程的新的產能也將上線。二零一四年會是個令人激動的一年。“

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一三年十月二十三日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：

中國 400-620-8038 (密碼：SMIC)

香港 852-2475-0994 (密碼：SMIC)

臺灣 886-2-2650-7825 (密碼：SMIC)

美國 1-845-675-0437 (密碼：SMIC)

二零一三年第二季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php，或

<http://www.media-server.com/m/p/k3yzasi5>。

該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發佈後 12 個月內刊登於 SMIC 的網站上。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”，紐交所代號：SMI，港交所股份代號：981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和一座 200mm 超大規模晶圓廠。在北京建有一座 300mm 超大規模晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳正開發一個 200mm 晶圓廠項目。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區提供客戶服務和設立行銷辦事處，同時在香港設立了代表處。

詳細資訊請參考中芯國際網站 www.smics.com

安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一三年第四季指引”裡中芯國際首席執行官引述的最後一段，以及關於二零一三年未來資本開支的聲明，乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。這些前瞻性陳述涉及可能導致中芯國際實際表現、財務狀況和經營業績與這些前瞻性陳述所表明

的意見產生重大差異的已知和未知風險、不確定性因素和其他因素，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，其中包括全球經濟變緩、未決訴訟的頒令或判決，和終端市場的財政穩定等相關風險。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文檔資料，包括其於二零一三年四月十五日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「合併財務報表」部分，且中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性陳述，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明陳述的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因為新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

關於非一般公認會計準則(“非公認準則”)的財務計量

為補充中芯國際遵照國際財務報告準則表達的合併財務結果，中芯國際在此份新聞稿裡使用了營運結果的計量，其調整為不包含來自武漢新芯集成電路製造有限公司(“武漢新芯”)的晶圓轉單(於二零一三年第三季起正逐步結束)。此份業績報告包含非公認準則的收入(非公認準則的銷售額)、非公認準則的銷售成本及非公認準則的毛利率，亦包含二零一三年第四季財務指引裡的非公認準則的收入(非公認準則的銷售額)、非公認準則的銷售成本及非公認準則的毛利率，皆不包含來自武漢新芯的晶圓轉單；以及非公認準則的營運開支，其調整為不包含匯兌損益、雇員花紅計提數、在研究發展合約上獲得政府支持的資金以及出售生活園區資產收益的影響。非公認準則的財務計量表達，並不意味著可以僅考慮非公認準則的財務計量，或認為其可替代遵照國際財務報告準則準備及表達的財務資訊。

中芯國際相信使用這些非公認準則的財務計量，有助於投資者及管理層比較中芯國際過去的業績，本公司管理層規律地使用這些非公認準則財務計量去了解、管理和評估本公司的業務以及去制定財務和營運方面的決策。

後附的表格在每項非公認準則的財務計量及直接可比的公認準則財務計量之間的調節，有更多的資訊。指引裡的非公認準則計量及公認準則計量之間的調節，在未來的基礎上並不可行。

二零一三年第三季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度	二零一二年 季度比較	二零一二年 第三季度	二零一二年 年度比較
收入	534,256	541,302	-1.3%	461,168	15.8%
銷售成本	(422,274)	(406,075)	4.0%	(334,347)	26.3%
毛利	111,982	135,227	-17.2%	126,821	-11.7%
經營開支	(63,447)	(56,095)	13.1%	(106,455)	-40.4%
經營利潤	48,535	79,132	-38.7%	20,366	138.3%
其他開支，淨額	(4,681)	(3,292)	42.2%	(7,335)	-36.2%
除稅前利潤	43,854	75,840	-42.2%	13,031	236.5%
所得稅開支	(914)	(510)	79.2%	(1,112)	-17.8%
本期利潤	42,940	75,330	-43.0%	11,919	260.3%
其他綜合收入					
外幣報表折算差異變動	77	278	-72.3%	258	-70.2%
本期綜合收入總額	43,017	75,608	-43.1%	12,177	253.3%
中芯國際應佔利潤	42,491	75,401	-43.6%	11,966	255.1%
毛利率	21.0%	25.0%	-	27.5%	-
每股普通股股份盈利-基本及攤薄 ⁽¹⁾	0.00	0.00	-	0.00	-
每股美國預托股份盈利-基本及攤薄	0.07	0.12	-	0.02	-
付運晶圓(約當 8 吋)	653,090	687,651	-5.0%	605,543	7.9%
產能利用率 ⁽²⁾	88.2%	98.5%	-	92.0%	-

附注：

- (1) 基於二零一三年第三季加權平均普通股 320 億 8 仟 400 萬股(基本)及 323 億 5 仟 500 萬股(攤薄)，二零一三年第二季 320 億 5 仟 100 萬股(基本)及 323 億 1 仟 200 萬股(攤薄)，二零一二年第三季 319 億 8 仟 300 萬股(基本)及 319 億零 9 仟 300 萬股(攤薄)。
- (2) 產能利用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

- 二零一三年第三季銷售額由二零一三年第二季的 5 億 4 仟 1 佰 30 萬元下降 1.3%至 5 億 3 仟 4 佰 30 萬元，主要由於來自武漢新芯的轉單銷售額減少。本公司於二零一三年第三季起逐步結束來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額。
- 不包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，二零一三年第三季非公認準則的銷售額為 5 億零 3 佰 70 萬元，相比二零一三年第二季為 5 億零 1 佰 80 萬元。
- 二零一三年第三季的銷售成本由二零一三年第二季的 4 億零 6 佰 10 萬元上升 4.0%至 4 億 2 仟 2 佰 30 萬元。
- 二零一三年第三季的毛利由二零一三年第二季的 1 億 3 仟 5 佰 20 萬元減少 17.2%至 1 億 1 仟 2 佰萬元。

- 二零一三年第三季的毛利率由二零一三年第二季的 25.0% 下降至 21.0%，主要由於本季較低的產能利用率及產品組合改變所致。
- 不包含來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額，二零一三年第三季非公認準則的毛利率由二零一三年第二季的 26.7% 下降至 22.1%。
- 二零一三年第三季的經營開支由二零一三年第二季的 5 仟 6 佰 10 萬元增加 13.1% 至 6 仟 3 佰 40 萬元，主要原因請詳下文經營開支（收入）分析。

收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度	二零一二年 第三季度
電腦	1.8%	1.5%	1.5%
通訊	44.4%	45.6%	46.7%
消費	43.9%	45.3%	43.1%
其他	9.9%	7.6%	8.7%
以服務分類	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度	二零一二年 第三季度
晶圓	93.8%	96.2%	94.9%
光罩製造，晶圓測試及其它	6.2%	3.8%	5.1%
以客戶類別分類	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度	二零一二年 第三季度
無廠房半導體公司	87.7%	87.7%	86.8%
集成裝置製造商	5.5%	7.0%	8.8%
系統公司及其它	6.8%	5.3%	4.4%
以地區分類	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度	二零一二年 第三季度
北美洲	46.0%	48.3%	55.2%
中國 ⁽¹⁾	42.1%	40.9%	35.3%
歐亞 ⁽²⁾	11.9%	10.8%	9.5%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度	二零一二年 第三季度
40/45 納米	15.7%	10.0%	0.8%
55/65 納米	27.1%	30.9%	34.8%
90 納米	4.7%	4.6%	9.4%
0.13 微米	10.1%	10.5%	11.8%
0.15/0.18 微米	38.4%	40.1%	37.5%
0.25/0.35 微米	4.0%	3.9%	5.7%

附註：

- (1) 包括香港，不包括臺灣
- (2) 不包括中國

產能*

晶圓廠/(晶圓尺寸)	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度
上海廠(8吋)	90,000	90,000
上海 12吋廠(12吋)	24,750	18,000
北京廠(12吋)	81,000	81,000
天津廠(8吋)	36,000	34,500
晶圓代工生產月產能合計	231,750	223,500

附注：

*在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數，且爲了比較目的，以 30 天作爲計算基礎。

- 二零一三年第三季的月產能由二零一三年第二季的 22 萬 3 仟 500 片 8 吋晶圓增加至 23 萬 1 仟 750 片晶圓，主要由於上海 12 吋廠的產能擴充。

付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度	二零一二年 季度比較	二零一二年 第三季度	二零一二年 年度比較
付運晶圓	653,090	687,651	-5.0%	605,543	7.9%
產能利用率 ⁽¹⁾	88.2%	98.5%	-	92.0%	-

附注：

(1) 產能使用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度	季度比較	二零一二年 第三季度	年度比較
銷售成本	422,274	406,075	4.0%	334,347	26.3%
折舊	126,433	107,759	17.3%	93,258	35.6%
其他製造成本	294,374	295,840	-0.5%	240,620	22.3%
股權報酬	1,467	2,476	-40.8%	469	212.8%
毛利	111,982	135,227	-17.2%	126,821	-11.7%
毛利率	21.0%	25.0%	-	27.5%	-

- 二零一三年第三季的銷售成本由二零一三年第二季的 4 億零 6 佰 10 萬元上升 4.0%至 4 億 2 仟 2 佰 30 萬元。
- 二零一三年第三季歸屬於銷售成本的折舊增加至 1 億 2 仟 6 佰 40 萬元，相比二零一三年第二季為 1 億零 7 佰 80 萬元。
- 二零一三年第三季歸屬於銷售成本的其他製造成本減少至 2 億 9 仟 4 佰 40 萬元，相比二零一三年第二季為 2 億 9 仟 5 佰 80 萬元。
- 二零一三年第三季的毛利由二零一三年第二季的毛利 1 億 3 仟 5 佰 20 萬元減少 17.2%至 1 億 1 仟 2 佰萬元。
- 二零一三年第三季的毛利率由二零一三年第二季的 25.0%下降至 21.0%，主要由於本季較低的產能利用率及產品組合改變所致。

經營開支（收入）分析

以千美元計	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度	季度比較	二零一二年 第三季度	年度比較
經營開支	63,447	56,095	13.1%	106,455	-40.4%
研究及開發開支	37,564	36,736	2.3%	72,945	-48.5%
一般及行政開支	24,718	42,636	-42.0%	24,859	-0.6%
銷售及市場推廣開支	9,324	9,775	-4.6%	8,178	14.0%
其他經營開支(收入)	(8,159)	(33,052)	-75.3%	473	-

- 二零一三年第三季的研究及開發開支為 3 仟 7 佰 60 萬元，相比二零一三年第二季為 3 仟 6 佰 70 萬元。該季度增加數 6 佰 80 萬元主要由於較多的研究發展活動所致，但有部分被研究發展合約上獲得政府支持的資金增加數 6 佰萬元抵銷，該資金在二零一三年第三季為 9 佰萬元，相比二零一三年第二季為 3 佰萬元。
- 二零一三年第三季的一般及行政開支由二零一三年第二季的 4 仟 2 佰 60 萬元下降 42.0%至 2 仟 4 佰 70 萬元，主要由於本季雇員花紅計提數減少所致。
- 二零一三年第三季的其他經營收入為 8 佰 20 萬元，相比二零一三年第二季為 3 仟 3 佰 10 萬元，主要包含處置部分屬於本公司的上海生活園區資產所產生的收益。季度減少的 75.3%，主要由於本公司於第二季錄得處置對中芯國際開發管理（武漢）有限公司的全部所有權所產生的一次性收益。

其他收入（開支），淨額

以千美元計	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度	季度比較	二零一二年 第三季度	年度比較
其他收入（開支），淨額	(4,681)	(3,292)	42.2%	(7,335)	-36.2%
利息收入	1,394	936	48.9%	1,088	28.1%
財務費用	(8,673)	(9,080)	-4.5%	(11,150)	-22.2%
外幣匯兌收益或虧損	2,404	2,949	-18.5%	1,405	71.1%
其他收益或虧損	(357)	1,126	-	537	-
應佔聯營公司利潤	551	777	-29.1%	785	-29.8%

- 其他收益或虧損的變動，主要由於暑假期間來自學校的收入減少所致。

折舊及攤銷

以千美元計	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度	季度比較	二零一二年 第三季度	年度比較
折舊及攤銷	136,725	135,712	0.7%	143,219	-4.5%

流動資金

以千美元計	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度
現金及銀行結餘	473,507	262,955
限制性現金	195,813	214,430
其他財務資產	2,574	2,881
貿易及其他應收賬款	396,108	472,426
預付經營開支	48,383	57,231
存貨	289,954	308,328
歸類為持作出售資產	210	922
流動資產總計	1,406,549	1,319,173
流動稅項負債	85	143
其他財務負債	10	107
承兌票據	14,895	14,791
預提負債	105,497	104,678
遞延政府補助	17,833	26,924
借貸	548,385	586,425
貿易及其他應付款項	402,827	537,003
流動負債總計	1,089,532	1,270,071
現金比率	0.4x	0.2x
速動比率	1.0x	0.8x
流動比率	1.3x	1.0x

資本結構

以千美元計	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度
現金及銀行結餘	473,507	262,955
限制性現金	195,813	214,430
長期票據即期部分	14,895	14,791
短期借款	548,385	586,425
長期借款	553,435	474,692
借款總計	1,101,820	1,061,117
股本	2,559,381	2,403,738
總債務股本比率 ⁽¹⁾	43.1%	44.1%

附注：

(1) 總債務股本比率為借款總計除以股本。借款總計包含短期和長期借款。

二零一三年第三季現金及銀行結餘由二零一三年第二季的 2 億 6 仟 3 佰萬元增加 80.1% 至 4 億 7 仟 3 佰 50 萬元，主要因為 1) 收到已成立的北京合資公司其他投資方投入的部分認繳資本金 1 億零 8 佰萬元及 2) 本公司在二零一三年第三季提取部分銀行借款。

現金流量概要

以千美元計	二零一三年 第三季度	二零一三年 第二季度
經營活動所得現金淨額	269,581	108,360
投資活動所用現金淨額	(213,133)	(242,559)
融資活動所得現金淨額	154,045	104,167
滙率變動的影響	59	55
現金變動淨額	210,552	(29,977)

資本開支概要

- 二零一三年第三季資本開支為 1 億 6 仟 9 佰 30 萬元。
- 二零一三年計劃用於晶圓廠運作的資本開支為 6 億 7 仟 5 佰萬元。
- 二零一三年計劃資本開支金額並未計及北京合資公司的額外開支，該合資公司於二零一三年七月成立。該合資公司主要從事(其中包括)測試、開發、設計、製造、封裝及銷售集成電路。
- 此外，我們在二零一三年編列預算 1 億 3 仟萬元，用以建造僱員生活園區，此為本公司留才計劃的一部分。我們計劃於未來出租或出售園區內的房舍予僱員。

近期公佈

- 中芯國際 IP 研發中心採用華大九天 EDA 解決方案 (2013-10-04)
- 中芯國際推出多元化 eNVM 技術平台 (2013-09-23)
- 中芯國際連續三年被列入恒生可持續發展企業基準指數 (2013-09-11)
- 授出購股期權 (2013-09-09)
- 中芯國際採用 Cadence 數位流程 (2013-09-04)
- 中芯國際 2013 年度技術研討會盛大開幕 (2013-09-04)
- 通函一致新登記股東之信函及回條—選擇公司通訊之收取方式及語言版本 (2013-09-03)
- 通函—非登記股東之通知信函及申請表格(2013-09-03)
- 通函—登記股東之通知信函及變更申請表格 (2013-09-03)
- 截至二零一三年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈 (2013-08-26)
- 董事會會議日期通知 (2013-08-14)
- 董事名單與其角色和職能(2013-08-08)
- 委任獨立非執行董事 (2013-08-08)
- 中芯國際截至二零一三年六月三十日止三個月未經審核業績公佈 (2013-08-08)
- 董事會會議日期通知 (2013-07-19)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php 及 http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

簡明合併損益及其他綜合收入表

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一三年 九月三十日 (未經審核)	二零一三年 六月三十日 (未經審核)
收入	534,256	541,302
銷售成本	(422,274)	(406,075)
毛利	111,982	135,227
研究及開發開支	(37,564)	(36,736)
一般及行政開支	(24,718)	(42,636)
銷售及市場推廣開支	(9,324)	(9,775)
其他經營收入	8,159	33,052
經營利潤	48,535	79,132
其他開支，淨額	(4,681)	(3,292)
除稅前利潤	43,854	75,840
所得稅開支	(914)	(510)
本期利潤	42,940	75,330
其他綜合收入		
<i>其後或會重新歸類為損益的項目</i>		
外幣報表折算差異變動	77	278
本期綜合收入總額	43,017	75,608
本期以下各方應佔利潤:		
本公司擁有人	42,491	75,401
非控制權益	449	(71)
	42,940	75,330
本期以下各方應佔其他綜合收入總額:		
本公司擁有人	42,568	75,679
非控制權益	449	(71)
	43,017	75,608
中芯國際應佔每股股份盈利，基本及攤薄	0.00	0.00
中芯國際應佔每股美國預托股份盈利，基本及攤薄	0.07	0.12
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	32,083,651,959	32,051,257,487
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	32,354,552,218	32,311,620,628
比較公認準則計量而調節出非公認準則的財務計量⁽¹⁾		
非公認準則的收入	503,669	501,844
非公認準則的銷售成本	(392,407)	(367,610)
非公認準則的毛利率	22.1%	26.7%

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

簡明合併損益及其他綜合收入表(續)

(以千美元為單位，每股資料除外)

附註:

- (1) 中芯國際將非公認準則的收入、非公認準則的銷售成本及非公認準則的毛利率(此為非公認準則的財務計量)定義為，皆不包含來自武漢新芯晶圓轉單的收入、銷售成本及毛利率。中芯國際一併覆核了收入、銷貨成本及毛利率和非公認準則的財務計量，去了解、管理和評估其業務，以及去制定營運和財務方面的決策。本公司也相信這些補充資訊對投資者及分析人員用以評估公司在不包含來自武漢新芯晶圓轉單銷售額(並非產自公司的產品線產能)後的營運表現來說是有用的。中芯國際已於二零一三年三月作出公告，停止代武漢新芯經營管理在武漢的300mm晶圓廠，且於二零一三年第三季起正逐步結束來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額。然而，把非公認準則的財務計量當作一項分析工具來使用是有重大限制的，其中一個限制就是使用非公認準則的財務計量，並不包括影響到當期淨利潤的所有項目。此外，因為非公認準則的財務計量不會被其他公司用相同的方法計算，相對於其他公司在使用類似名稱的計量上，或許無法比較。根據上述提到的限制，對於遵照國際財務報告準則編制的收入、銷貨成本及毛利率，不應該僅考慮非公認準則的財務計量，或認為非公認準則的財務計量是可選擇的。

下表列示在有關期間由遵照國際財務報告準則編製的收入、銷售成本及毛利率(此為最直接可比較的財務計量)，調節至各項非公認準則的收入、非公認準則的銷售成本及非公認準則的毛利率。

	截至以下日期止三個月		
	二零一三年 九月三十日 (未經審核)	二零一三年 六月三十日 (未經審核)	二零一二年 九月三十日 (未經審核)
收入	534,256	541,302	461,168
武漢新芯的收入	(30,587)	(39,458)	(47,391)
非公認準則的收入	503,669	501,844	413,777
銷售成本	(422,274)	(406,075)	(334,347)
武漢新芯的銷售成本	29,867	38,465	46,204
非公認準則的銷售成本	(392,407)	(367,610)	(288,143)
毛利率	21.0%	25.0%	27.5%
非公認準則的毛利率	22.1%	26.7%	30.4%

中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併財務狀況表
(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一三年 九月三十日 (未經審核)	二零一三年 六月三十日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	2,558,563	2,523,893
預付土地使用權	123,974	124,818
無形資產	227,380	228,898
於聯營公司的投資	23,758	23,189
遞延稅項資產	43,889	43,802
其他資產	36,969	37,926
非流動總資產	3,014,533	2,982,526
<i>流動資產</i>		
存貨	289,954	308,328
預付經營開支	48,383	57,231
貿易及其他應收款項	396,108	472,426
其他財務資產	2,574	2,881
受限制現金	195,813	214,430
現金及銀行結餘	473,507	262,955
	1,406,339	1,318,251
歸類為持作出售資產	210	922
流動總資產	1,406,549	1,319,173
總資產	4,421,082	4,301,699
權益及負債		
<i>股本及儲備</i>		
普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股。於二零一三年九月三十日及二零一三年六月三十日已發行及流通股份分別為 32,088,989,727 股及 32,075,631,400 股。	12,836	12,830
股份溢價	4,088,854	4,088,071
儲備	56,993	53,079
累計虧絀	(1,708,540)	(1,751,031)
本公司擁有人應佔權益	2,450,143	2,402,949
非控制權益	109,238	789
總權益	2,559,381	2,403,738

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

簡明合併財務狀況表(續)

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一三年 九月三十日 (未經審核)	二零一三年 六月三十日 (未經審核)
<i>非流動負債</i>		
借貸	553,435	474,692
遞延稅項負債	207	257
遞延政府補助	213,098	147,952
長期財務負債	5,429	4,989
非流動總負債	772,169	627,890
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	402,827	537,003
借貸	548,385	586,425
遞延政府補助 ⁽¹⁾	17,833	26,924
預提負債	105,497	104,678
承兌票據	14,895	14,791
其他財務負債	10	107
流動稅項負債	85	143
流動總負債	1,089,532	1,270,071
總負債	1,861,701	1,897,961
權益及負債合計	4,421,082	4,301,699

附註:

(1) 本公司就二零一三年六月三十日的部分非流動遞延政府補助重分類至流動負債項下。

中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併現金流量表
(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一三年 九月三十日 (未經審核)	二零一三年 六月三十日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤	42,940	75,330
折舊及攤銷	136,725	135,712
應佔聯營公司利潤	(551)	(777)
營運資金的變動及其它	90,467	(101,905)
經營活動所得現金淨額	269,581	108,360
投資活動:		
對物業、廠房及設備的付款	(255,561)	(188,008)
對無形資產的付款	(9,414)	(14,914)
對土地使用權的付款	-	(61,391)
出售物業、廠房及設備及無形資產所得款項	15,140	7,553
與投資活動有關的受限制現金變動	7,305	(12,721)
收購財務資產付款	(5,225)	(2,852)
出售財務資產所得款項	5,518	1,215
出售子公司股權所得款項	29,104	28,639
其他	-	(80)
投資活動所用現金淨額	(213,133)	(242,559)
融資活動:		
借款所得款項	434,170	306,939
償還借款	(388,671)	(189,323)
償還承兌票據	-	(15,000)
行使雇員認股權所得款項	546	1,551
來自非控股權益之款項	108,000	-
融資活動所得現金淨額	154,045	104,167
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	59	55
現金及銀行結餘增加(減少)淨額	210,552	(29,977)
現金及銀行結餘－期間開始	262,955	292,932
現金及銀行結餘－期間結束	473,507	262,955

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張文義(董事長)

邱慈雲(首席執行官)

高永崗

非執行董事

陳山枝(及其替任董事李永華)

劉遵義(及其替任董事陳大同)

周杰

獨立非執行董事

William Tudor Brown

馬宏升 (Sean Maloney)

孟樸

陳立武

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

邱慈雲

首席執行官兼執行董事

中國上海

二零一三年十月二十二日

* 僅供識別